

NC273LT SOLDADURA EN PASTA NO CLEAN

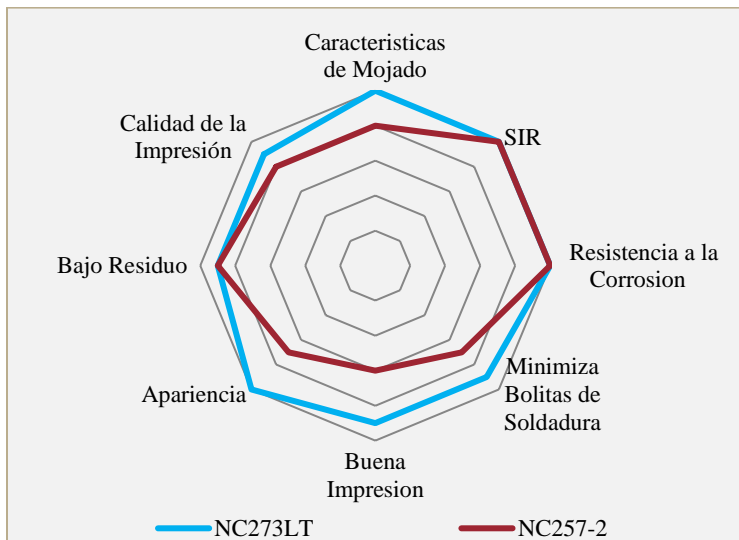
CARACTERÍSTICAS

- Diseñada para aplicaciones a baja temperatura
- Cumple la norma RoHS
- Minimiza la formación de bolitas de soldadura
- Efecto de mojado mejorado para aleaciones con bismuto
- Vida en el estencil > 8 horas
- Libre de halógenos

DESCRIPCIÓN

El revolucionario sistema activador de la soldadura en pasta para bajas temperaturas NC273LT de AIM, mejora el desempeño del mojado de las aleaciones que contienen bismuto, ofreciendo acabados que cumplen con la norma RoHS. La NC273LT ofrece larga vida de estencil, excelente eficiencia de transferencia y reduce las probabilidades de generación de bolitas de soldadura, típicas en procesos donde se utilizan aleaciones con alto contenido de bismuto. Cuando la exposición térmica durante el proceso es una limitación, la NC273LT es un excelente reemplazo, compatible con la norma RoHS. Las soldaduras en pasta con contenido de bismuto disminuyen el pico máximo en el perfil de reflujo a temperaturas tan bajas como 170°C-185°C (338°F-365°F). Al igual que con cualquier aleación que contenga bismuto, el ensamble debe ser completamente libre de plomo.

CARACTERÍSTICAS



MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Parámetro	Tiempo	Temperatura
Vida útil de pasta cerrada y refrigerada	4 meses	0°C-12°C (32°F-55°F)
Vida útil de pasta cerrada no refrigerada	2 semana	< 25°C (< 77°F)

No agregue pasta usada al contenedor de pasta nueva. La pasta usada deberá ser almacenada por separado y la pasta nueva requiere un sellado hermético, ya sea con tapa interna o tapón. Una vez abierta, la vida útil de la soldadura en pasta dependerá de la aplicación y el entorno. Consulte la guía de manejo de pasta de AIM para más información. La aleación y las condiciones de almacenamiento pueden afectar la vida útil. Consulte el Certificado de Análisis de NC273LT para información específica del producto.

LIMPIEZA

Antes del reflujo: Se recomienda el uso del limpiador AIM DJAW-10 que remueve eficazmente los residuos de soldadura en pasta con bismuto NC273LT de la superficie de estenciles y aperturas. Puede ser aplicado a mano o con el sistema automático de limpieza del equipo de impresión de pasta. No se recomienda aplicar en exceso o directamente al estencil por la parte superior, no mezclar DJAW-10 con Alcohol Isopropílico (IPA) o cualquier otro solvente. Alcohol Isopropílico (IPA) puede ser utilizado al final del proceso de limpieza del estencil con DJAW-10 solo como enjuague.

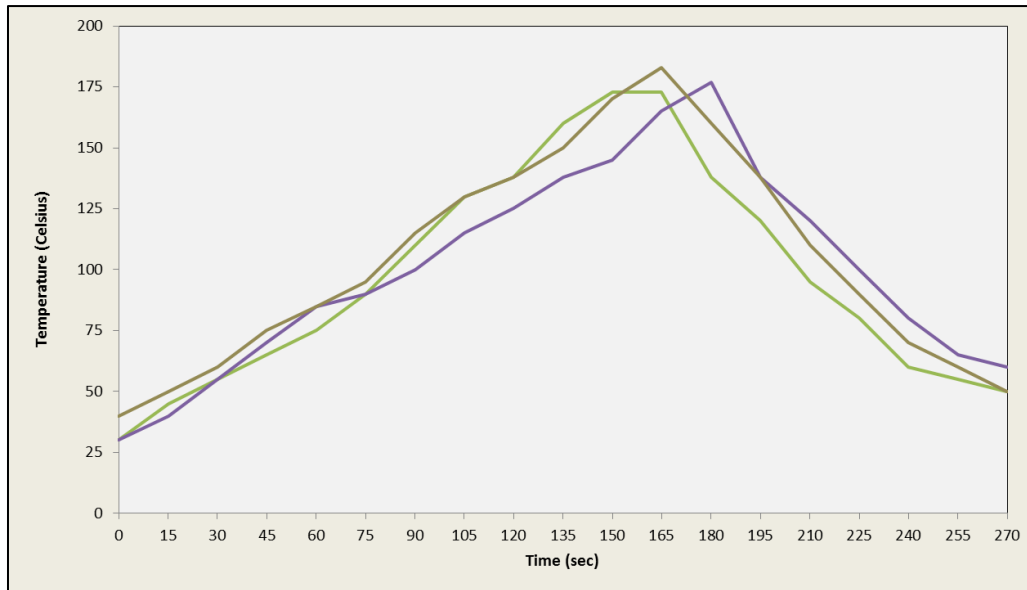
Después del Reflujo: Los residuos la soldadura en pasta con bismuto NC273LT de AIM pueden permanecer sobre el ensamble después del reflujo y no requieren limpieza. Cuando un proceso limpio sea requerido, comuníquese con AIM para obtener mayor información sobre procesos limpios.

Document Rev # NF11
Page 1 of 4

CONDICIONES DE USO La información aquí contenida se basa en datos considerados como precisos y se ofrece sin cargo alguno. La información sobre el producto se basa en el hecho de asumir que el manejo y las condiciones de operación son los adecuados. No se acepta responsabilidad por pérdidas o lesiones que provengan del uso de esta información o de alguno de los materiales designados. Refiérase a <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> para revisar términos y condiciones de AIM.

PERFIL DE REFLUJO

La información proporcionada es sólo una guía. El perfil adecuado para su producto dependerá de varios factores, incluyendo la aleación, tipo de flux, materiales, limitaciones de componentes, características del horno, masa térmica del tablero, etc. En última instancia, los requerimientos de calidad debe definir el proceso.



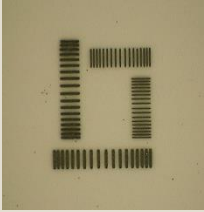

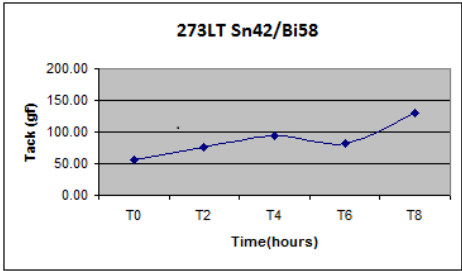
Índice de calentamiento 1-3°C / Seg. Max.	Rampa a 100°C (212°F)	Rampa de 100°C-140°C (212°F- 284°F)	Rampa a pico 170°C-185°C (338°F- 365°F)	Tiempo sobre liquido 138°C (280°F)	Rampa de Enfriamiento ≤ 4°C/Seg	Tiempo de inicio al pico máximo
	≤ 75 Seg	30-60 Seg	45-75 Seg	50-80 Seg	45 ± 15 Seg	2.75-3.5 Min

IMPRESIÓN

Configuración Inicial Recomendada - Varía de acuerdo al tipo y diseño del PCB o pad	
Parámetro	Valor Inicial Recomendado
Presión de las Navajas	0.9 -1.5 libra/pulgada de navaja
Velocidad de las Navajas	0.5 - 6 pulgada/segundo
Distancia de Separación (Snap-off)	En contacto - 0.00 mm
Distancia de Desprendimiento entre PCB y estencil	0.75 - 2.0 mm
Velocidad de Desprendimiento entre PCB y estencil	3 - 20 mm/Segundo

DATOS DE PRUEBAS

Nombre	Método de Prueba	Resultado	
Clasificación de IPC	J-STD-004 3.2.3.1	ROLO	
Clasificación de IPC	J-STD-004B 3.3.1.2.1	ROL1	
Nombre	Método de Prueba	Resultado	Imagen
Prueba de Corrosión Inducida por el Método Espejo de Cobre	J-STD-004B 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.32	BAJO	
Pruebas de Propiedades Corrosivas de los Residuos de Fundente.	J-STD-004B 3.4.1.2 IPC-TM-650 2.6.15	PASA	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Antes</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Después</p>  </div> </div>
Contenido de Haluro(s) por Método de Cromatografía Iónica	J-STD-004B 3.4.1.3 IPC-TM-650 2.3.28.1	Br: 0.23% Cl: 0.0% Valor Típico	
Contenido de halógenos	EN14582	<900ppm Br/Cl <1500ppm	Libre de halógenos
Presencia de Haluro(s) por Método de Cromato de Plata	J-STD-004B 3.5.1.1 IPC-TM-650 2.3.33	PASA	
Presencia de Fluoruro(s) por Método de Punto	J-STD-004B 3.5.1.2 IPC-TM-650 2.3.35.1	Sin Fluoruros	
Resistencia Aislante de la Superficie (SIR)	J-STD-004B 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.7	PASA	
Contenido de Sólidos No Volátiles en el Fundente	J-STD-004B 3.4.2.1 IPC-TM-650 2.3.34	3.17 Valor Típico	
Índice de Acidez del Fundente	J-STD-004B 3.4.2.2 IPC-TM-650 2.3.13	159.4 mg KOH/ g flux	
Gravedad Especifica	J-STD-004B 3.4.2.3 ASTM D-1298	0.98	
Viscosidad	J-STD-005A 3.5.1 IPC-TM-650 2.4.34	Fórmula para Imprimir: 750kcps Valor Típico Fórmula para dispensado: 400kcps Valor Típico	

Nombre	Método de Prueba	Resultado	Imagen												
Inspección Visual	J-STD-004B 3.4.2.5	Gris, Suave, Cremosa													
Prueba colapsamiento de la Soldadura en Pasta (Slump)	J-STD-005A 3.6 IPC-TM-650 2.4.35	PASA													
Prueba de Esfera de Soldadura	J-STD-005A 3.7 IPC-TM-650 2.4.43	PASA													
Prueba de retención (Tack)	J-STD-005A 3.8 IPC-TM-650 2.4.44	55.3gf	 <table border="1"> <caption>273LT Sn42/Bi58 Tack Data</caption> <thead> <tr> <th>Time (hours)</th> <th>Tack (gf)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T0</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>T2</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>T4</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>T6</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>T8</td> <td>130</td> </tr> </tbody> </table>	Time (hours)	Tack (gf)	T0	50	T2	75	T4	90	T6	80	T8	130
Time (hours)	Tack (gf)														
T0	50														
T2	75														
T4	90														
T6	80														
T8	130														
Prueba de Mojado (Wetting)	J-STD-005A 3.9 IPC-TM-650 2.4.45	PASA	